

# **Chin Su Kao pharmaceutical paster within a water soluble substrate compound and manufacture process thereof**

**Publication number:** TW520299 (B)

**Publication date:** 2003-02-11

**Inventor(s):** LIN CHUAN-FU [TW]; CHEN FEN [TW]; CHEN LIANG-HUA [TW]; LAI HUNG-LIANG [TW]; CHEN GAN-LIN [TW] +

**Applicant(s):** PHARMACEUTICAL INDUSTRY TECHNO [TW] +

**Classification:**

- international: **A61K9/70; A61K47/00; A61K9/70; A61K47/00;** (IPC1-7): A61K47/00; A61K9/70

- European:

**Application number:** TW19980108001 19980522

**Priority number(s):** TW19980108001 19980522

## **Abstract of TW 520299 (B)**

The present invention relates to a Chin Su Kao pharmaceutical paster within a water soluble substrate compound and manufacture process thereof, which is used for curing tendon contusion. The conventional external pharmaceutical paster is composed by oily substrate, which easily leads to allergy in derma, The Chin Su Kao water soluble colloid pharmaceutical paster in present invention has been passed through animal evaluation model to pick and weed out the formula of the Chin Su Kao pharmaceutical paster. The total manufacture process fits modern quality control and quality assurance for stabilizing the effect of the Chinese medicine.

---

Data supplied from the **espacenet** database — Worldwide

中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號：520299

[44]中華民國 92年 (2003) 02月 11日  
發明

全 2 頁

[51] Int.Cl<sup>07</sup> : A61K9/70  
A61K47/00

[54]名稱：水性金絲膏貼劑及其製法

[21]申請案號：087108001

[22]申請日期：中華民國 87年 (1998) 05月 22日

[72]發明人：

林傳福

陳芬

陳亮樺

賴宏亮

陳甘霖

許哲

臺北市北投區吉利街八十四號

臺北市內湖區康寧路一段一九五巷三弄三號二樓

臺北市信義區基隆路二段一六七巷五號三樓

臺北市大安區安和路二段八十八號四樓之三

臺北市汐止市長青路二一〇巷六弄十六號

臺北縣永和市永平路一五七巷六弄二號二樓

[71]申請人：

財團法人製藥工業技術發展  
中心

臺北縣汐止市康寧街一六九巷一〇一號五樓

[74]代理人：樊貞松 先生  
王雲平 先生

1

2

[57]申請專利範圍：

1.一種水性金絲膏貼劑，包括：

(1)剝離層：由聚烯烴聚合物所構成；

(2)貯藥層：由水性高分子化合物之聚合物所構成，其內放置含金絲膏濃縮萃取液，其為當歸尾、川白芷、杏仁、玄參、豬牙皂角及草烏各 11.25 克，及乳香 18.75 克、沒藥 18.75 克、白膠香 300 克、蔥 150 克、松香 300 克，加入 1~20 倍乙醇水溶液加熱迴流萃取、濃縮；該水性高分子化合物為 0.5~12 重量 % 聚丙烯酸鈉、1~20 重量 % 羧基乙烯聚合物及 1~5 重量 % 聚乙稀醇所成之交聯反應產物；及

(3)背層：由不織布或纖維材料所構成。

2.如申請專利範圍第 1 項所述之水性金絲膏貼劑，其中之水性高分子化合物 1~5 重量 % 聚乙稀醇可以 1~10 重量 % 聚乙稀吡咯烷酮替代。

3.如申請專利範圍第 1 項所述之水性金絲膏貼劑，其中之水性高分子化合物可再添加 1~10 重量 % 聚乙稀吡咯烷酮。

4.如申請專利範圍第 1 項所述之水性金絲膏貼劑，其中貯藥層之金絲膏濃縮萃取液含量比例為 2~10 重量 %。

5.一種含中藥金絲膏之水性透皮貼劑之製法，包括下列步驟：

(2)

3

(1)將適量的甘油、水、山梨醇攪拌均勻，適時加入高嶺土及水性高分子化合物，該水性高分子化合物為、0.5~12 重量% 聚丙烯酸鈉、1~20重量% 羧基乙烯聚合物及1~5重量% 聚乙烯醇所成之交聯反應產物；

(2)加入將金絲膏濃縮萃取液、薄荷、水楊酸甲酯、對羟基苯甲酸丙酯及對羟基苯甲酸甲酯之混合液，即可得含藥膠體；該金絲膏濃縮萃取液為當歸尾、川白芷、杏仁、玄參、豬牙皂角及草烏各 11.25 克，及乳香 18.75 克、沒藥 18.75 克、白膠香 300 克、蔥 150 克、松香 300 克，加入 1~20 倍乙醇水溶液加熱迴流萃

4

取、濃縮而成；及

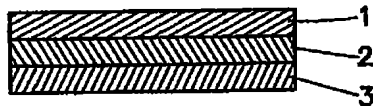
(3)然後，將含藥膠體塗敷於襯裡片上，其上再覆以一層剝離層，以形成水溶性金絲膏貼劑。

5. 6.如申請專利範圍第5項所述含中藥金絲膏之水性透皮貼劑之製法，其中步驟(1)之水性高分子化合物 1~5 重量% 聚乙烯醇可以 1~10 重量% 聚乙烯吡咯烷酮替代。

10. 7.如申請專利範圍第5項所述含中藥金絲膏之水性透皮貼劑之製法，其中步驟(1)之水性高分子化合物可再添加 1~10 重量% 聚乙烯吡咯烷酮。

圖式簡單說明：

15. 第一圖為水性金絲膏貼劑之示意圖



第一圖